



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen.
 printed circuit board layout, components side view
 modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
P 137 S	8	38

Verpackung: lose im Kunststoffbeutel
 Packaging: in bulk, in a plastic bag
 Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique

P 137 S

Modular-Einbaukupplung, 8P8C (RJ-45), mit Schirmung, abgewinkelte Ausführung, mit Flansch, für Leiterplatten

1. Werkstoffe

Kontaktträger	PBT GF, V0 nach UL 94
Kontakt	Cu-Legierung, unternickelt und selektiv vergoldet
Lötkontakt	Cu-Legierung, unternickelt und verzinkt
Gehäuse	PBT GF, V0 nach UL 94
Schirmung	Cu-Legierung, verzinkt

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit	Modularsteckern P 129, P 129 S
-------------------	--------------------------------

P 137 S

Modular chassis socket, 8P8C (RJ-45), with shielding, angular version, with flange, for printed circuit boards

1. Materials

Insulating body	PBT GF, V0 according to UL 94
Contact	Cu alloy, pre-nickelated and selectively gilded
Solder contact	Cu alloy, pre-nickelated and tinned
Housing	PBT GF, V0 according to UL 94
Shielding	Cu alloy, tinned

2. Mechanical data

Mating with	modular plugs P 129, P 129 S
-------------	------------------------------

P 137 S

Embase femelle modulaire, 8P8C (RJ-45), avec blindage, version angulaire, avec collet, pour cartes imprimées

1. Matériaux

Corps isolant	PBT GF, V0 suivant UL 94
Contact	Cu alliage, sous-nickelé et doré sélectivement
Contact à souder	Cu alliage, sous-nickelé et étamé
Boîtier	PBT GF, V0 suivant UL 94
Blindage	Cu alliage, étamé

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec	connecteurs modulaires mâles P 129, P 129 S
-------------------	---